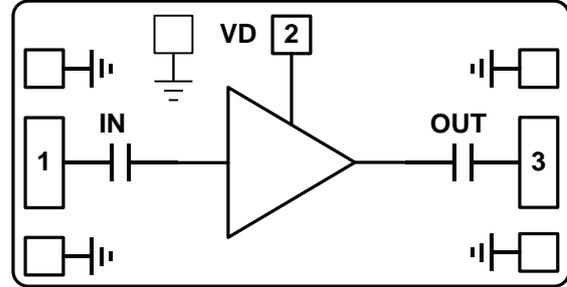




### 主要特点

- 工作频率: 2 - 6 GHz
- 增益: 21 dB
- 噪声系数: 2.0 dB
- P1dB: +22.5 dBm@+5V
- Psat: +24 dBm@+5V
- 供电: 自偏置 +5/+6 V @ 190 mA
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 1.5 × 1 × 0.1 mm<sup>3</sup>

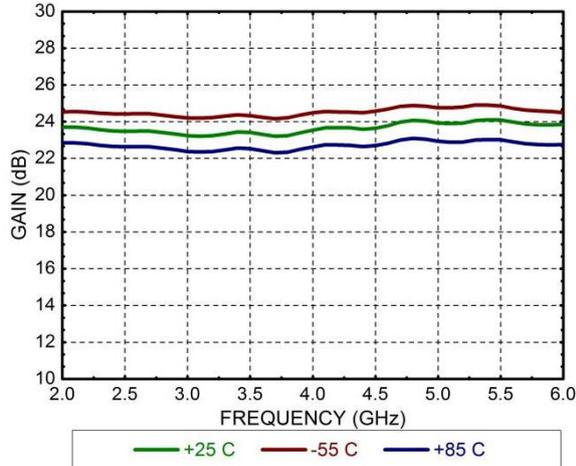
### 功能框图



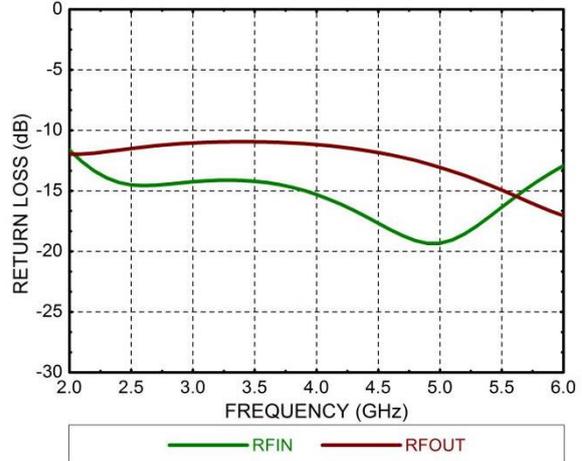
### 性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , $V_{DD} = +5/+6\text{ V}$ , $I_{DD} = 190\text{ mA}^*$ )

参数	VDD=+5V			VDD=+6V			单位
	最小	典型	最大	最小	典型	最大	
频率范围	2-6			2-6			GHz
增益		23			23		dB
增益平坦度		±0.6			±0.6		dB
输入回波损耗		15			15		dB
输出回波损耗		12			15		dB
输出功率 1dB 压缩点		22.5			24		dBm
饱和功率		24			25.5		dBm
输出 IP3		33			34		dBm
噪声系数		2.3			2.3		dB
工作电流	150	187	230	150	193	230	mA

### 增益 VDD=+5V

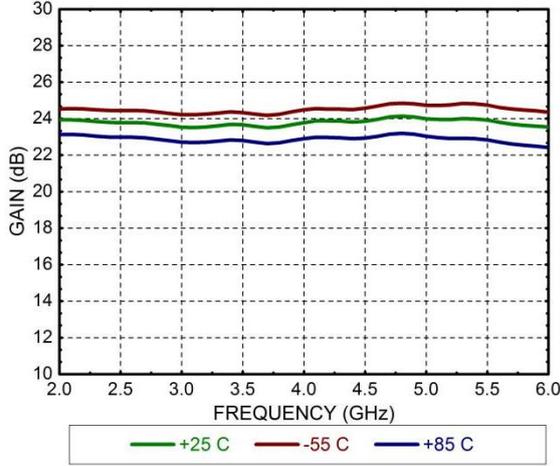


### 回波损耗 VDD=+5V

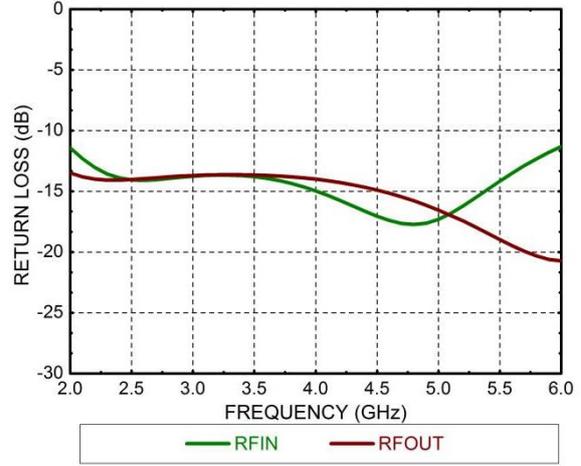




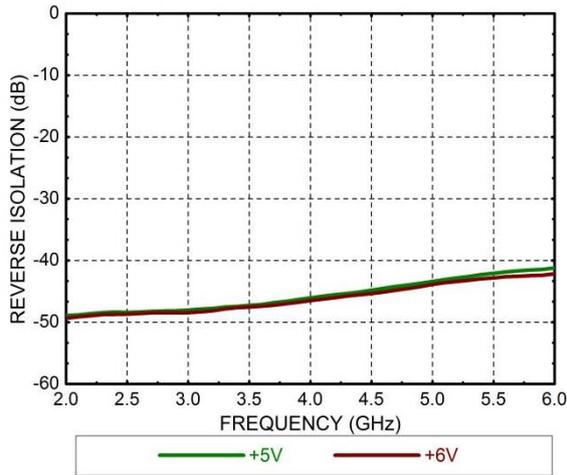
增益 VDD=+6V



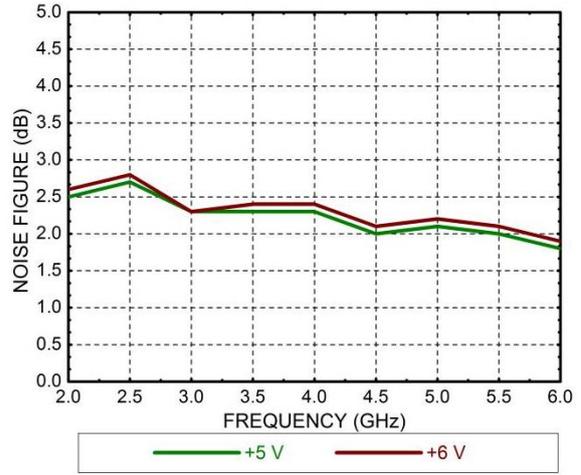
回波损耗 VDD=+6V



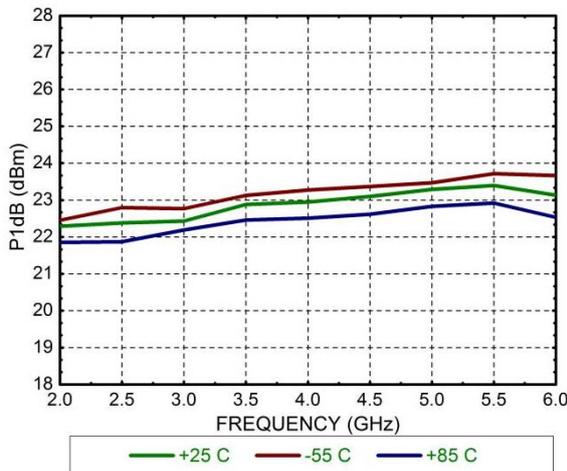
反向隔离度



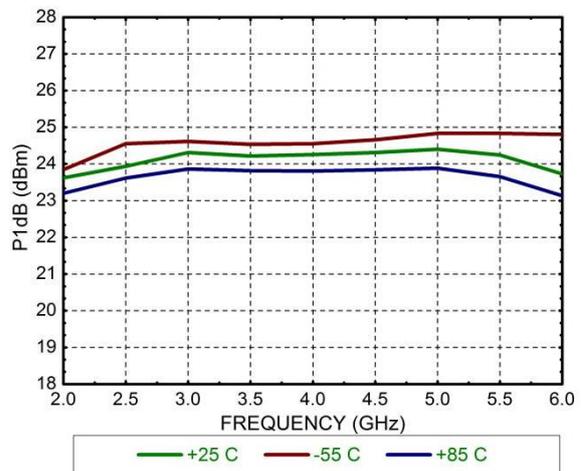
噪声系数



输出功率P1dB VDD=+5V

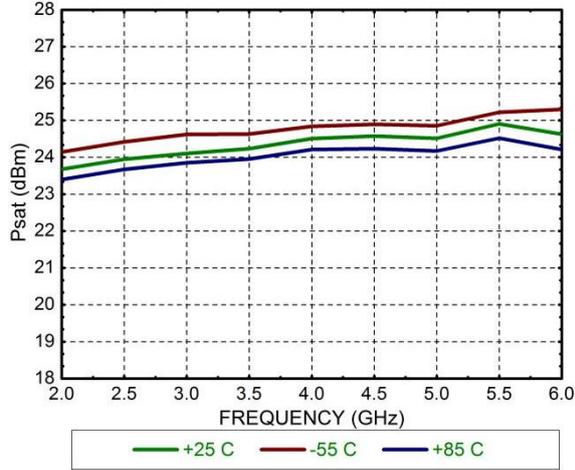


输出功率P1dB VDD=+6V

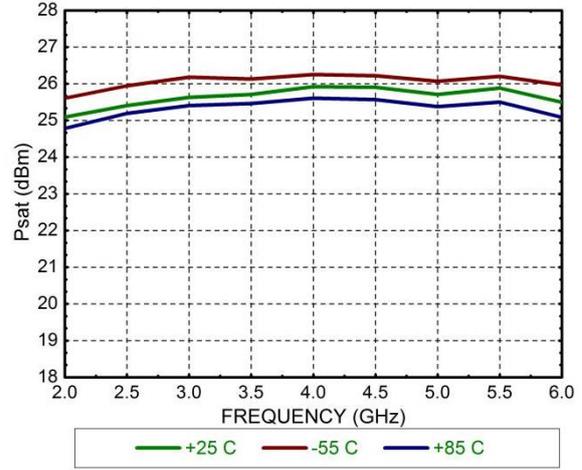




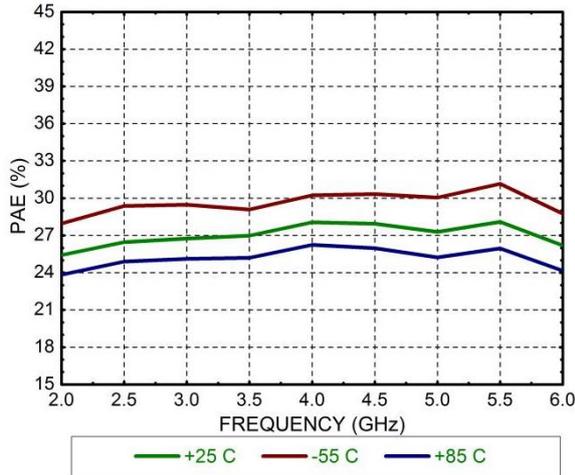
输出功率Psat VDD=+5V



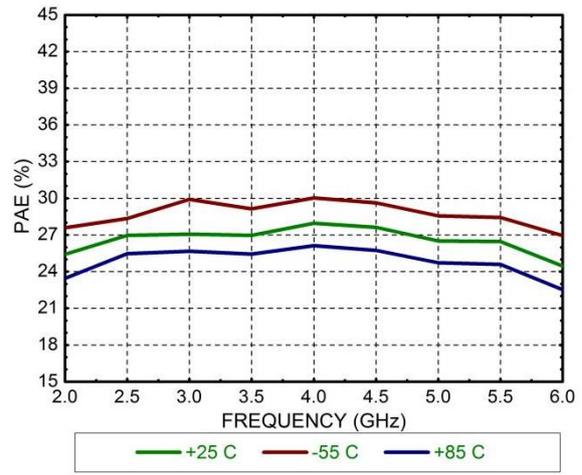
输出功率Psat VDD=+6V



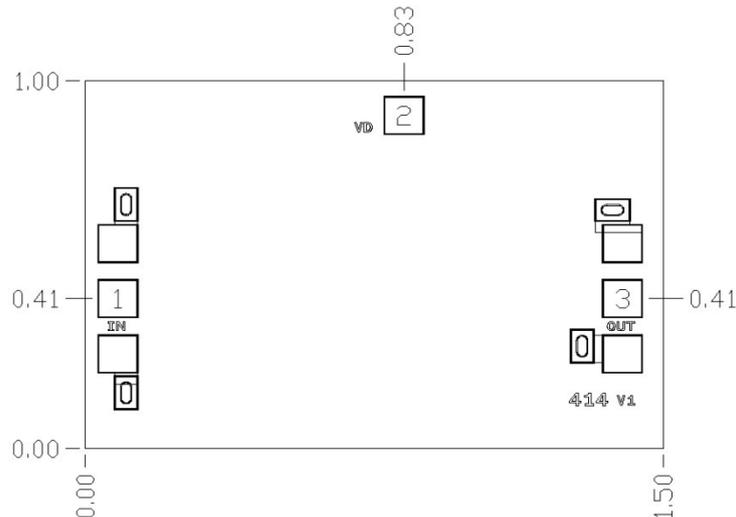
PAE @ Psat VDD=+5V



PAE @ Psat VDD=+6V



### 物理参数

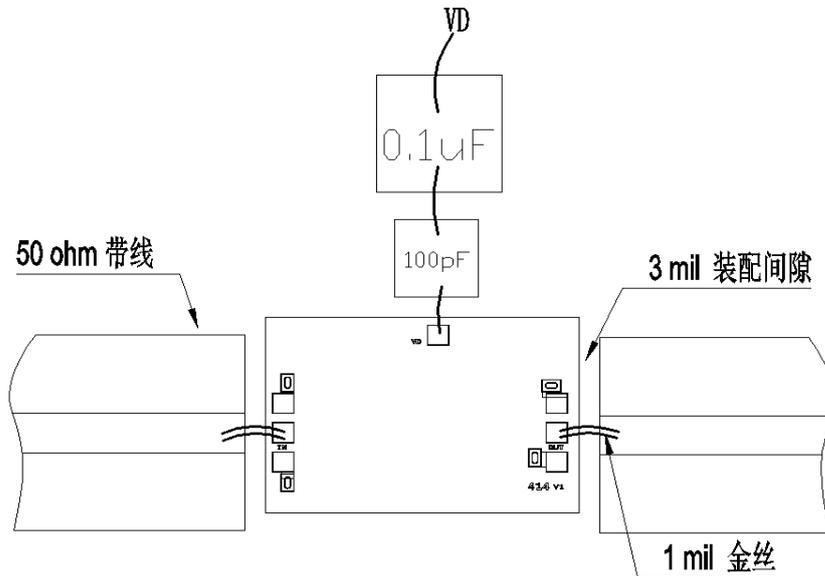




## 焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是 AC 耦合，匹配至 50 Ohm
2	VD	该焊盘是电源端口，需要外接 100pF 旁路电容
3	OUT	该焊盘是 AC 耦合，匹配至 50 Ohm
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

## 装配图



装配注意事项：100pF 芯片电容尽量靠近芯片。

## 注意事项

1. 芯片厚度为 100 um
2. 典型键合焊盘尺寸为 100\*100 um<sup>2</sup>
3. 键合焊盘金属化：金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 需要共晶烧结装配
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 本产品采用空气桥工艺，表面不带钝化层

## 极限参数

1. 电源电压：+7 V
2. 射频输入功率：+18 dBm
3. 储存温度：-65 ~ +150 °C
4. 工作温度：-55 ~ +85 °C